

公司概況資料表

以下資料由印能科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：印能科技股份有限公司 (股票代號：7734)

董事長	洪誌宏
總經理	洪誌宏
資本額	200,850,000
輔導推薦證券商	台新綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	台新綜合證券股份有限公司，李小姐02-5570-8888
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購印能科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	台新綜合證券股份有限公司	宏遠證券股份有限公司
認購日期	113年1月16日、113年3月8日	
認購股數(股)	503,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.50%	0.50%
認購價格	每股新台幣489元	
認購價格之訂定依據及方式	(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較 本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，作為印能科技股份有限公司(以下簡稱印能公司或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由	

本推薦證券商與該公司共同議定之。

該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、市場法及興櫃市場流動性不足之風險，經與該公司議定之認購價格為489元。

基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

1. 市場基礎法：(1) 本益比法 (Price/Earnings Ratio, P/E Ratio) 及 (2) 股價淨值比法 (Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
2. 成本法，亦稱帳面價值法 (Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
3. 收益基礎法中之自由現金流量折現法 (Discounted Cash Flow Method, DCF) 則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購該公司僅就市場基礎法一本益比法進行評估。

(二) 發行人與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

該公司為半導體先進封裝製程問題解決的提供者，提供客戶氣動與熱能製程解決方案、自動化系統解決方案及相關零組件之設計開發、製造、銷售及維修服務，包括應用於先進封裝的壓力烤箱，高功率老化測試機及相關自動化之技術解決方案，產品皆為該公司自行研發之技術，取得將近30項製程、機構、方法等專利，提供客戶製程簡化、良率提升與成本效益之製程解決方案，目前客戶已遍及台灣、北美、歐洲、日本、韓國、中國、東南亞，客戶包含全球主要封裝廠，顯見該公司於先進封裝領域有其重要性，且實力深獲國際大廠肯定。

綜觀目前國內上市櫃公司營業產品種類，尚無業務內容與該公司完全相同者，經參酌該公司及同業之主要營業項目、營運規模、資本額及產品應用領域，選擇上櫃公司弘塑科技(股)公司(以下簡稱弘塑，股票代碼：3131)、上櫃公司萬潤科技(股)公司(以下簡稱萬潤，股票代碼：6187)上市公司及辛耘企業(股)公司(以下簡稱辛耘，股票代碼：3583)以作為採樣同業。取樣同業皆為先進封裝製程提供關鍵設備，就營業產品區分，弘塑和辛耘主要提供半導體後段封裝濕製程設備，萬潤為客戶提供的先進封裝製程設備為點膠機和自動光學檢測設備。

針對上述採樣同業112年11月份至113年1月份之本益比，茲評估說明如下：

單位：倍

採樣同業	月份			
	112年11月	112年12月	113年1月	平均
弘塑(3131)	27.75	30.18	32.00	29.98
萬潤(6187)	117.54	123.68	167.98	136.40
辛耘(3583)	29.04	28.12	28.32	28.49
上市股票-半導體業類	18.27	18.94	19.54	18.92
上櫃股票-半導體業類	28.32	28.70	29.51	28.84

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站

參考該公司採樣同業、上市半導體業類股及上櫃半導體業類股最近三個月(112年11月~113年1月)平均本益比，剔除極端值萬潤之平均值136.40後，經計算其採樣同業及上市、上櫃半導體業類股平均本益比區間落在18.92倍~29.98倍間，另依據該公司111年度及112年第二季經會計師查核簽證或核閱財務報告之最近四季(111年第三季止至112年第二季)稅後淨利為717,019千元，依擬興櫃掛牌時股份總數20,850千股計算之每股盈餘34.39元為計算基礎，按上述本益比區間計算其參考價格，價格區間約為650.66~1,031.01元，考量興櫃流動性風險給予7折計算，調整後本益比法計算之價格區間為455.46元~721.71元。

(三)推薦證券商就其與發行人所共同議定承銷價格合理性之評估意見。

綜上，考量本益比法評價之每股參考股價區間為455.46元~721.71元，另經參酌印能經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性、同業之市場狀況，及興櫃市場流通性不足等因素後，由興櫃推薦證券商與印能公司共同議定興櫃認購價格訂為每股489元，介於上述參考價格區間，應尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

印能設立於民國96年9月27日，主要業務為研究、設計、開發、製造及銷售半導體相關製程之除泡設備、封裝設備、檢驗測試設備、自動化設備、迴焊燒結設備及壓合退火設備。

印能專注於先進封裝製程解決方案，走在問題前沿預先部署客戶未來需要的製程問題解決方案。研發團隊累積十多年產業實務經驗，深知客戶製程痛點，優勢在於以提供解決製程問題而能推出多項創新產品與製程模組，透過高壓與低壓氣體在高溫與低溫的調和運用，利用材料間的物理作用，提供穩定並具彈性的製程環境以解決各類材料在封裝製程中所碰到的氣泡、散熱、翹曲、高溫熔焊等製程問題，以滿足不同材料的處理要求，且產品已開發出節能的快速升溫與高效能快速降溫等技術，不僅解決客戶的製程問題、降低製造成本，並提升製程效率。

二、歷史沿革

年度	項目
民國96年	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司成立，設立資本額為新臺幣 3,000 仟元整。 ● 第 1 代除泡世代領航機種 VFS: Void Free System
民國97年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”半導體封裝加工的除泡烤箱裝置”新型專利。
民國98年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”半導體封裝之晶片黏著膠層氣泡排除方法”發明專利。 ● 辦理現金增資新臺幣 5,000 仟元，增資後實收資本額為新臺幣 8,000 仟元。
民國101年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”壓力容器之氣體濃度控制裝置”新型專利。
民國102年	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司更名為「印能科技股份有限公司」。 ● 辦理現金增資新臺幣 22,000 仟元，增資後實收資本額為新臺幣 30,000 仟元。 ● 取得”具有延伸連通腔道結構之半導體封裝載熱裝置”新型專利。
民國103年	<ul style="list-style-type: none"> ● 進駐新竹科學園區竹南基地 ● 第 2 代新世代先進封裝除泡創新機種 VTS: Void Terminator System，應用於晶圓級封裝全自動化制程除泡系統。 ● 取得”利用氣體充壓以抑制載板翹曲的載板固定方法”、“晶片壓合裝置及方法”、“覆晶封裝製造方法”及”利用增加氣體密度的溫度調整方法”發明專利。
民國105年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”以壓差法抑制材料翹曲的方法”發明專利。 ● 通過 ISO9001 品質管理系統認證。 ● 推出應用於 Fan-Out Panel Level Packaging 面板級封裝除泡系統
民國106年	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理現金增資新臺幣 30,000 仟元，增資後實收資本額為新臺幣 60,000 仟元。 ● 取得”覆晶封裝製程及其焊接方法”、“用於電子元件的製造法與製造設備”及”壓力容器之氣體含量感測裝置”發明專利 ● 推出第一套自動彈匣搬運除泡系統
民國107年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”電子封裝結構之處理方法”發明專利
民國108年	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理現金增資新臺幣 45,350 仟元，增資後實收資本額為新臺幣 105,350 仟元。 ● 取得”用於製造電子元件的加熱與加壓處理爐”發明專利。 ● 榮獲第十九屆金峰獎十大傑出企業與十大傑出創新研發。 ● 第 3 代跨界格新機種 Pioneer & PRO 導入高溫真空加壓環境於凸塊制程的介電材料烘烤以及回焊制程
民國109年	<ul style="list-style-type: none"> ● 榮獲第二十九屆國家磐石獎、第二十七屆中小企業創新研究獎、第二十三屆小巨人獎。 ● 推出封裝廠最佳自動物料搬運解決方案。
民國110年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”高溫烤箱的溫度調整設備”及”高壓崩應測試設備”發明專利。 ● 通過 ISO27001 資訊安全管理系統認證。
民國111年	<ul style="list-style-type: none"> ● 盈餘轉增資 50,000 仟元，增資後實收資本額為新臺幣 155,350 仟元。 ● 第 3.5 代創新區塊控制機種為解決生產自動化。 ● 投資香港分公司(ABLEPRINT TECHNOLOGY HONGKONG LIMITED)，從事控股作業。 ● 設立上海孫公司(芯印能半導體(上海)有限公司)，從事生產銷售氣動與熱能製程設備。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得”翹曲抑制迴焊爐”、”接觸式電軌高架搬運車(OHT)集塵系統”及”電子元件加熱加壓處理爐快速整理裝置”發明專利。
民國112年	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理現金增資新台幣 31,500 仟元及員工認股權憑證 8,000 仟元，增資後實收資本額為新台幣 194,850 仟元。 ● 第 4 代 LEAPSolve Platform 為提供驅動高性能封裝技術解決平臺。 ● 總部遷至新竹香山。 ● 成立竹南分公司。 ● 取得”機動式天車自動化搬運軌道”及”氣體回收設備”發明專利 ● 12 月股票公開發行生效。
民國113年	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理現金增資新台幣 6,000 仟元，增資後實收資本額為新台幣 200,850 仟元。

三、經營理念：

印能經營理念秉持著：

(一)專業：

創新及品質，熟悉且持續精進了解封裝測試流程及目前與未來問題，於提供客戶製程解決方案的同時，並提出顯著成本降低方案。

(二)創新：

不生產市場已量產成熟之設備，以協助解決製程問題為使命，滿足客戶需求為宗旨，進而產品開發。

(三)品質：

品質的關鍵在於管理，透過 ISO9001品質系統管理原則，落實於各部門日常流程，並持續改進，以實現對客戶之品質承諾。

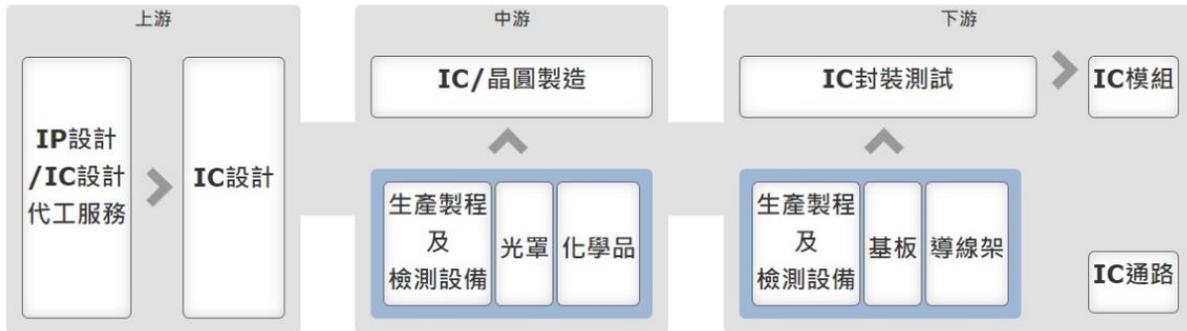
四、未來展望：

長/短期	計畫內容
短期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 技術創新和產品優化：加強研發投入與深化智慧財產權佈局，提升製程技術和設備性能，以符合先進製程的需求。 2. 市場佔有率：強化售後服務，提高客戶滿意度，與代理商客戶合作積極開拓新技術與新興市場，擴大市場佔有率。 3. 客戶關係：持續深耕封測市場之相關客戶群，維持穩固的長期合作關係，確保營收穩定成長。
長期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對先進封裝技術與小晶片(Chiplet)設計需求大幅成長，持續開發高階製程應用之相關技術和設備。 2. 因應半導體全球化走向區域化的供應鏈改變，積極擴大企業版圖及國際合作關係，維持領先地位。 3. 深化客戶信任和關係，持續與供應鏈緊密結合，保持競爭優勢。

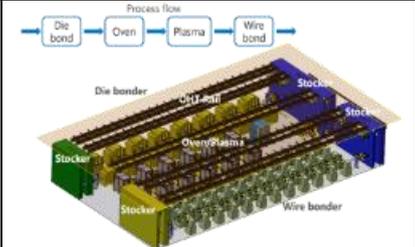
主要業務項目：

主要業務為研究、設計、開發、製造及銷售半導體相關製程之除泡設備、封裝設備、檢驗測試設備、自動化設備、迴焊燒結設備及壓合退火設備。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
氣動與熱能製程解決方案			986,197	83.19
自動化系統解決方案		以提供解決製程問題而能推出多項創新產品與製程模組，透過高壓與低壓氣體在高溫與低溫的調和運用，再並利用材料間的物理作用，提供穩定並具彈性的製程環境以解決各類材料在封裝製程中所碰到的氣泡、散熱、翹曲、高溫熔焊等製程問題	122,629	10.34

				
其他		零件、服務、維修等	76,703	6.47
合計			1,185,529	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年	109年	110年	111年	112年 (自結數) (註)	113年截至 1月份止 (自結數)(註)
營業收入		598,985	780,330	1,126,560	1,698,856	1,185,529	132,071
營業毛利		420,837	525,043	771,325	1,115,150	789,093	70,597
毛利率(%)		70.26%	67.28%	68.47%	65.64%	66.56%	53.45%
營業外收入		6,118	21,621	23,936	194,835	81,600	72,427
營業外支出		(14,966)	(55,768)	(25,465)	(5,959)	(28,079)	(1,323)
稅前損益		297,923	366,568	582,263	971,361	695,013	112,330
稅後損益		237,751	287,396	464,161	776,110	548,899	80,385
每股盈餘(元)		22.56	27.28	29.88	49.98	28.27	4.00
股利發放	現金股利(元)	8.12	9.82	12.7	27.67	尚未分配	尚未分配
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	4.75	-	-	-

(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年	109年	110年	111年	112年 (自結數)(註)
流動資產		738,103	960,960	1,421,698	2,314,894	2,810,987
基金及長期投資			1,582	-	-	-
固定資產		5,701	151,604	273,544	470,354	629,323
使用權資產			7,624	8,614	14,441	8,416
無形資產		1,106	875	2,917	2,104	3,566
其他資產		8,968	10,863	13,210	7,334	13,735
資產總額		753,878	1,133,508	1,719,983	2,809,127	3,466,027
流動	分配前	281,001	329,690	456,154	744,445	727,343

負債	分配後	366,591	433,164	589,949	1,174,345	尚未分配
非流動負債		-	129,190	228,514	382,431	544,906
負債 總額	分配前	281,001	458,880	684,668	1,126,876	1,272,249
	分配後	366,591	562,354	818,463	1,556,776	尚未分配
股本		105,350	105,350	105,350	155,350	194,850
資本公積		29,425	29,425	29,425	29,425	376,603
保留 盈餘	分配前	338,102	539,853	900,540	1,493,155	1,614,165
	分配後	252,512	436,379	766,745	1,063,255	尚未分配
其他權益		-	-	-	-323	-1,318
非控制權益		-	-	-	4,644	9,478
股東權益 總額	分配前	472,877	674,628	1,035,315	1,682,251	2,193,778
	分配後	387,287	571,154	901,520	1,252,351	尚未分配

(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

TOP ^

最近三年度財務比率

項目		年度	110年	111年	112年 (自結數)
財務 比率	毛利率(%)		68.47	65.64	66.56
	流動比率(%)		311.67	310.95	386.47
	應收帳款天數(天)		90.57	90.57	140.38
	存貨週轉天數(天)		83.33	69.39	142.02
	負債比率(%)		39.8	40.11	36.71

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)